



2024年5月27日

各 位

会社名 株式会社 JCU
代表者名 代表取締役社長兼CEO 木村 昌志
(コード番号：4975 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員経営戦略室室長
井上 洋二
(TEL. 03-6895-7004)

(訂正)「中期経営計画の策定に関するお知らせ」の一部訂正について

2024年5月10日に開示しました「中期経営計画の策定に関するお知らせ」にて、添付資料の中期経営計画「JCU VISION 2035 -1st stage-」で一部訂正すべき事項がございましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 訂正の主な理由

中期経営計画「JCU VISION 2035 -1st stage-」の開示後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正の内容

詳細は添付資料をご参照ください。訂正箇所には赤枠を付しております。

17 ページ：財務戦略 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
「PBR (FY18~FY23)」

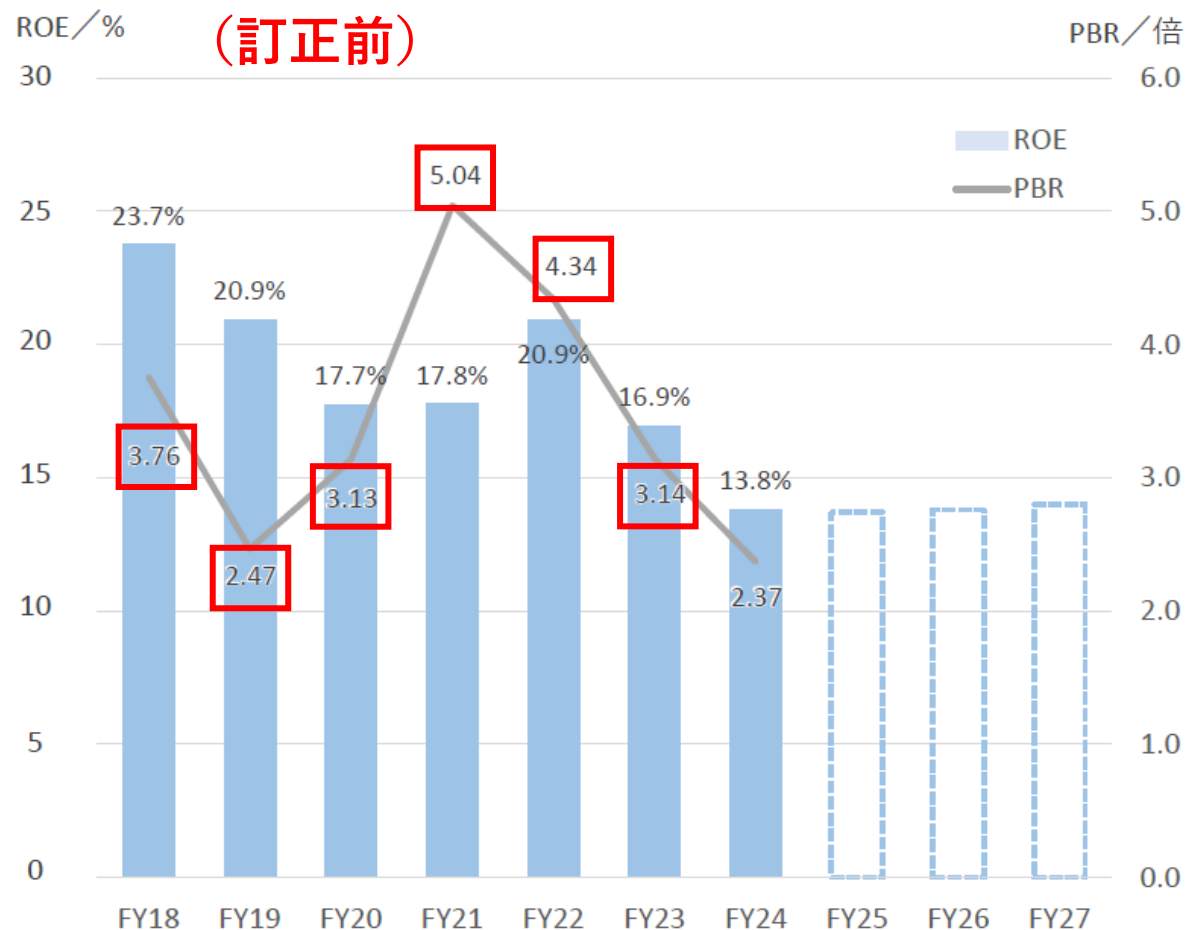
23 ページ：研究開発 | 研究開発投資
「研究開発費 (FY24)」

なお、訂正後の中期経営計画「JCU VISION 2035 -1st stage-」の全文につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト URL : <https://www.jcu-i.com/>

以 上

新中期経営計画「JCU VISION – 1st stage –」を着実に実行し、さらなる企業価値向上を目指す



現状認識

- ROEは13~20%台を推移し、資本コストを上回る水準を維持
- PBRは2~4倍程度を推移するが、FY2021以降は低下傾向
- FY2021以降のPBRの低下は、資本効率向上に向けた財務目標値など各種開示情報の不足が要因と認識

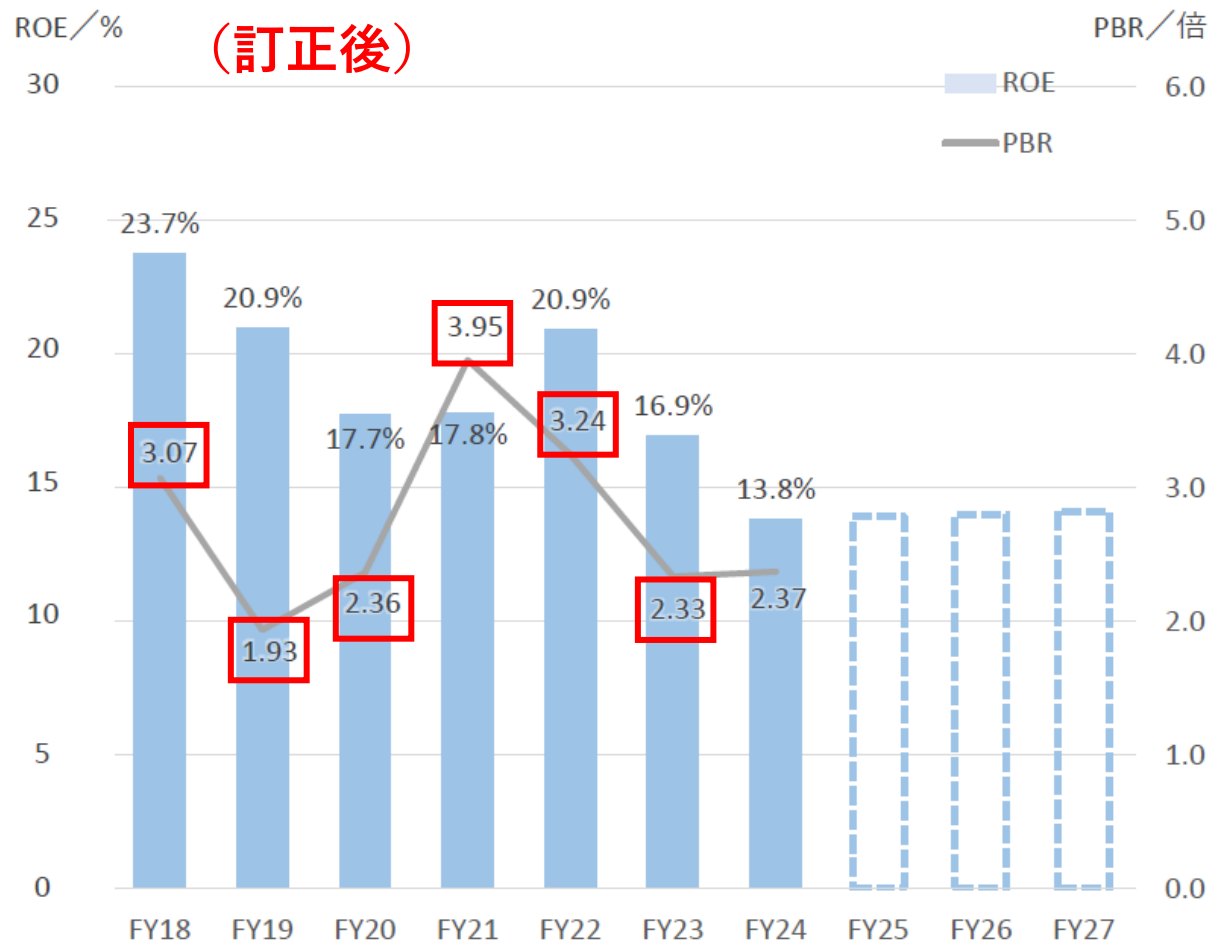
方針

- 中期経営計画における財務目標値の達成を目指す
- 資本政策に基づき、成長投資と株主還元を推進
- 経営の透明性を高め、必要とされる情報を積極的に開示

具体策

- 成長分野への積極投資（営業キャッシュ・フローの50%程度）
- 資本効率向上に向けた財務目標値の設定（ROE：14%以上 <FY2027時点>）
- 株主価値向上策の実施（総還元性向：50%目安、安定的な増配等）
- ホームページ、統合報告書など情報発信の充実

新中期経営計画「JCU VISION – 1st stage –」を着実に実行し、さらなる企業価値向上を目指す



現状認識

- ROEは13～20%台を推移し、資本コストを上回る水準を維持
- PBRは2～4倍程度を推移するが、FY2021以降は低下傾向
- FY2021以降のPBRの低下は、資本効率向上に向けた財務目標値など各種開示情報の不足が要因と認識

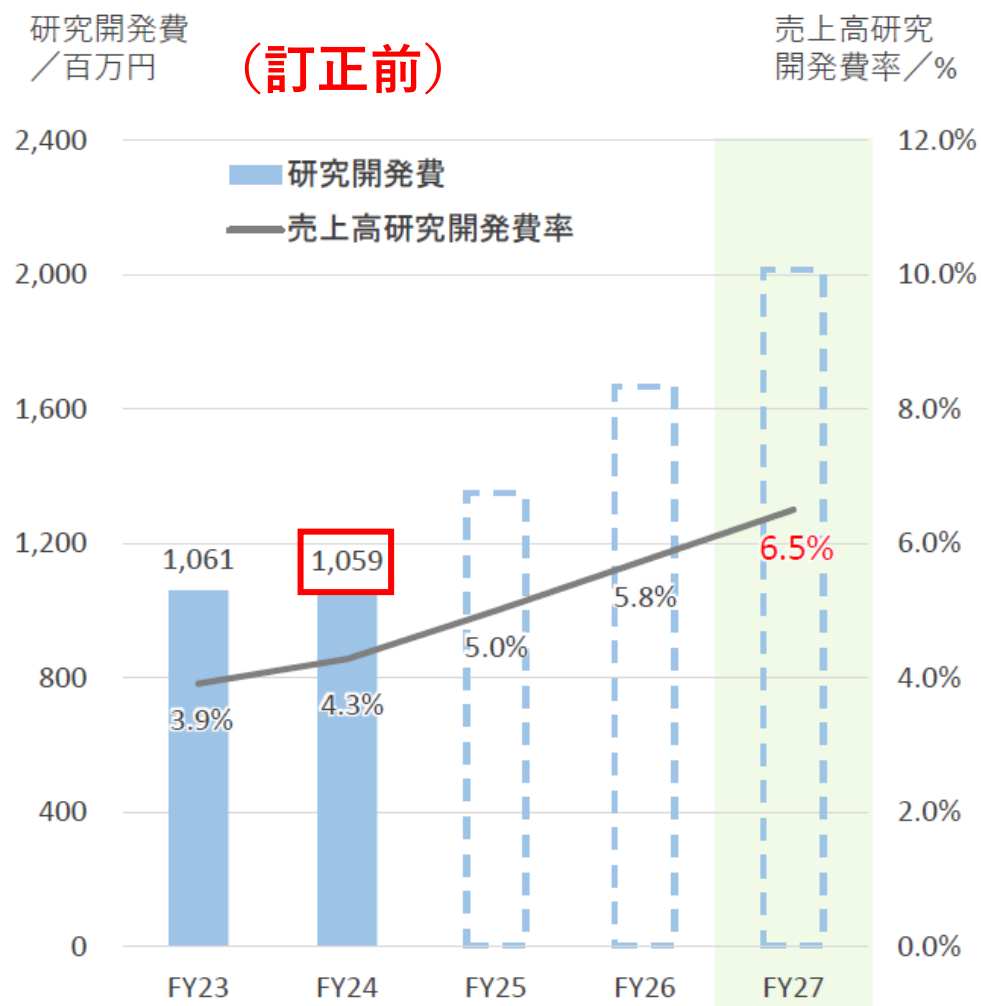
方針

- 中期経営計画における財務目標値の達成を目指す
- 資本政策に基づき、成長投資と株主還元を推進
- 経営の透明性を高め、必要とされる情報を積極的に開示

具体策

- 成長分野への積極投資（営業キャッシュ・フローの50%程度）
- 資本効率向上に向けた財務目標値の設定（ROE：14%以上 <FY2027時点>）
- 株主価値向上策の実施（総還元性向：50%目安、安定的な増配等）
- ホームページ、統合報告書など情報発信の充実

積極的に研究開発へ投資を行い、売上高研究開発費比率の目標を2027年3月期に6.5%とする



次世代領域

対象

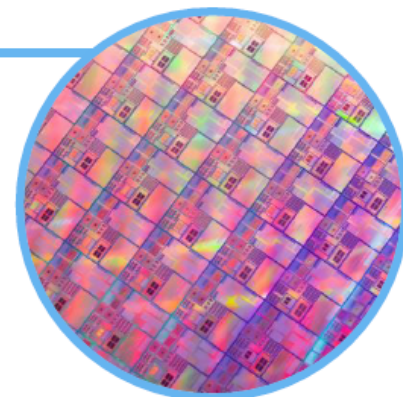
半導体アドバンスドパッケージ
(RDL, Cu Pillar, TSV, Hybrid Bonding etc.)

拠点

総合研究所・熊本事業所

製品

硫酸銅めっき薬品、エッチング薬品 (TIPHARES シリーズ)



重点領域

対象

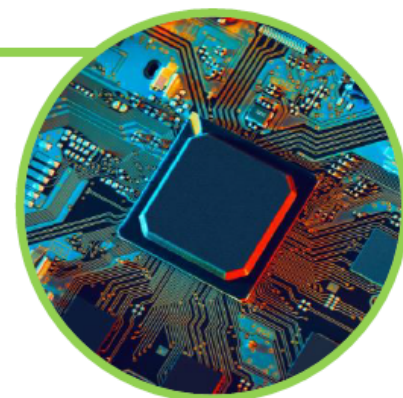
半導体パッケージ基板
(FC-BGA, WB-CSP, FC-CSP etc.)

拠点

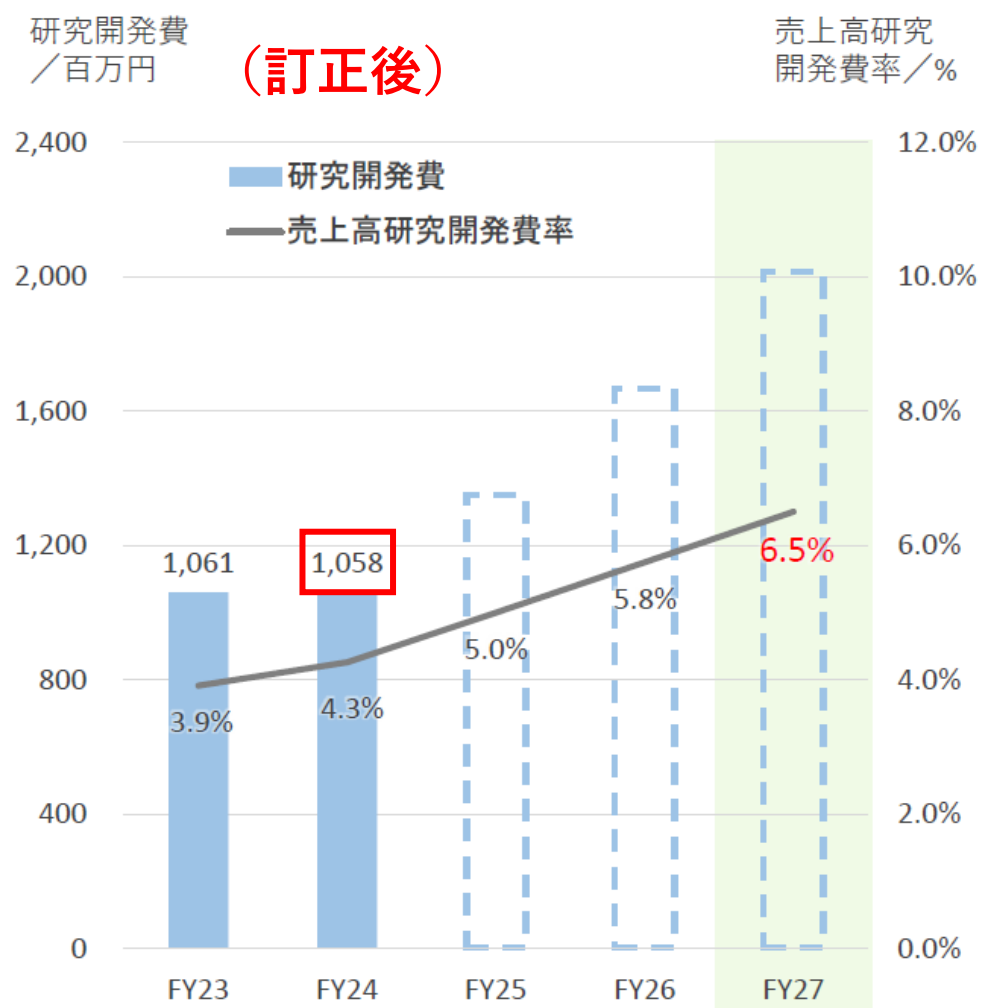
総合研究所

製品

硫酸銅めっき薬品 (CU-BRITE シリーズ)
エッチング薬品 (SAC シリーズ)



積極的に研究開発へ投資を行い、売上高研究開発費比率の目標を2027年3月期に6.5%とする



次世代領域

対象

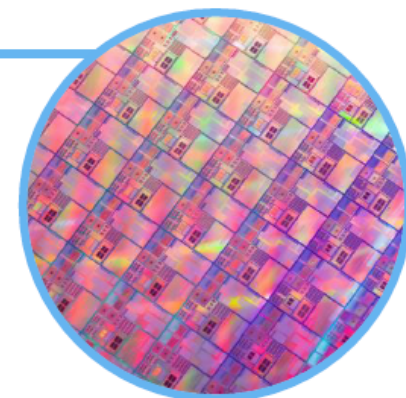
半導体アドバンスドパッケージ
(RDL, Cu Pillar, TSV, Hybrid Bonding etc.)

拠点

総合研究所・熊本事業所

製品

硫酸銅めっき薬品、エッチング薬品 (TIPHARES シリーズ)



重点領域

対象

半導体パッケージ基板
(FC-BGA, WB-CSP, FC-CSP etc.)

拠点

総合研究所

製品

硫酸銅めっき薬品 (CU-BRITE シリーズ)
エッチング薬品 (SAC シリーズ)

